

아날로그-디지털-파워
혼성신호 시스템반도체 SoC 리더



Iron Device
Corporation

Investor Relations 2026



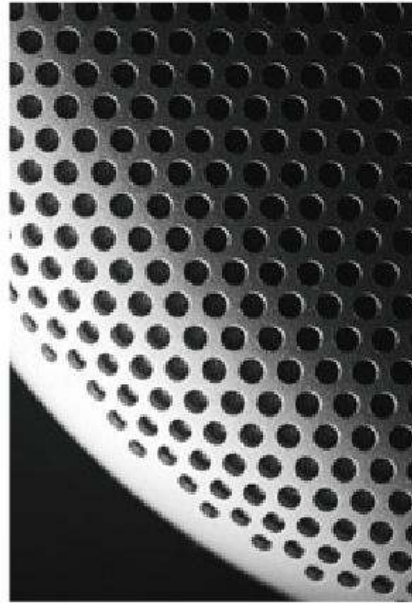
Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 아이언디바이스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다. 본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보” 는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보” 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



CONTENTS

01

Industry
Overview

02

About
Iron Device Corp.

03

Core
Business

04

New
Business

Appendix

01

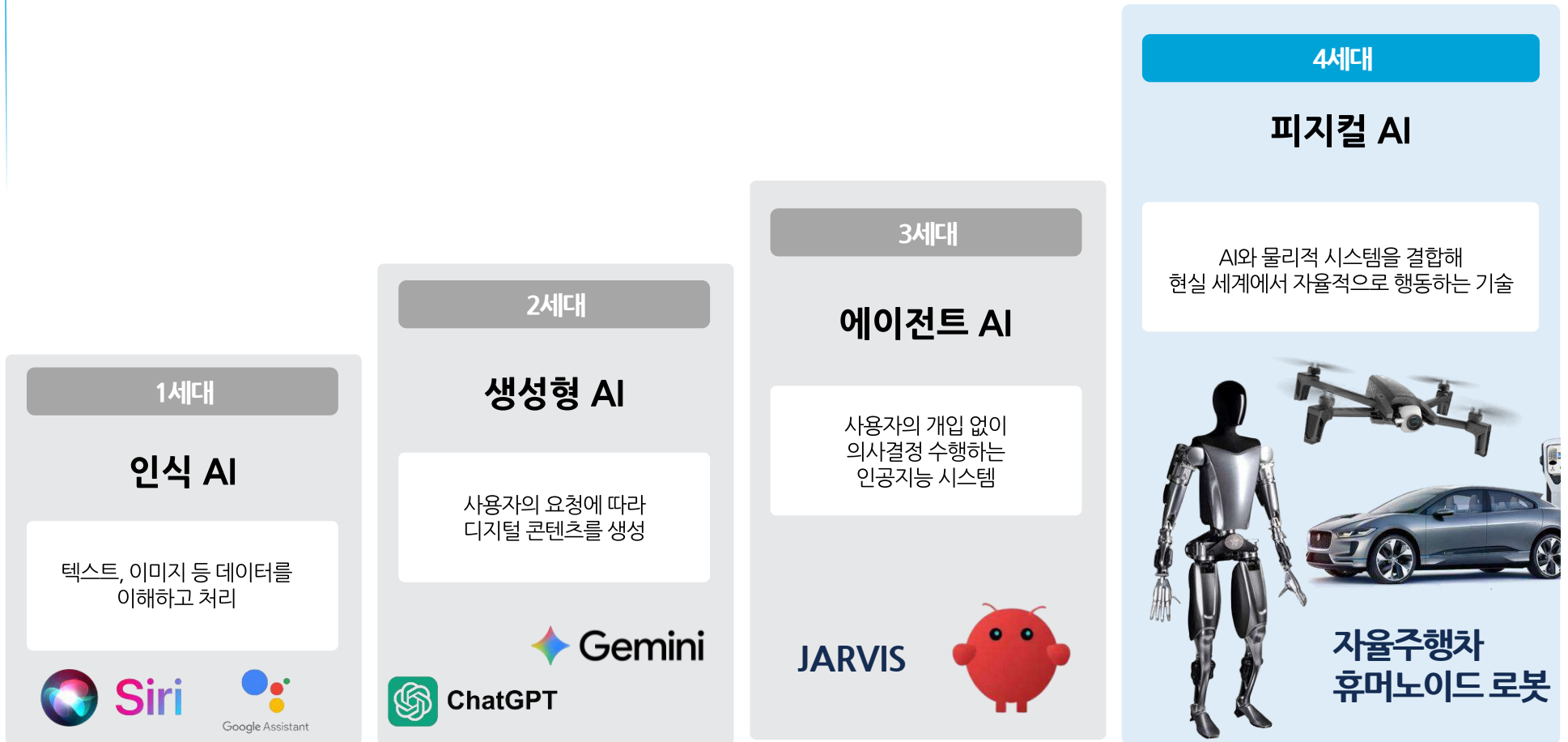
Industry Overview

피지컬 AI 시대 본격 개화
혼성신호 SoC 중요성 부각
혼성신호 SoC 기능
산업 특징



로봇공학(Robotics)과 인공지능(AI)이 융합된 피지컬 AI 시대 본격화

AI 기술 패러다임 전환: 디지털 인터페이스를 넘어 물리적 실체(Physical)로의 확장



전 영역에서 데이터를 효율적으로 구동시키는 핵심 역할 수행



“
**혼성신호 SoC
 핵심요소**
 ”

☑ 아날로그 신호의 입력 및 출력을 위한
정확한 데이터 센싱 및 처리 필요

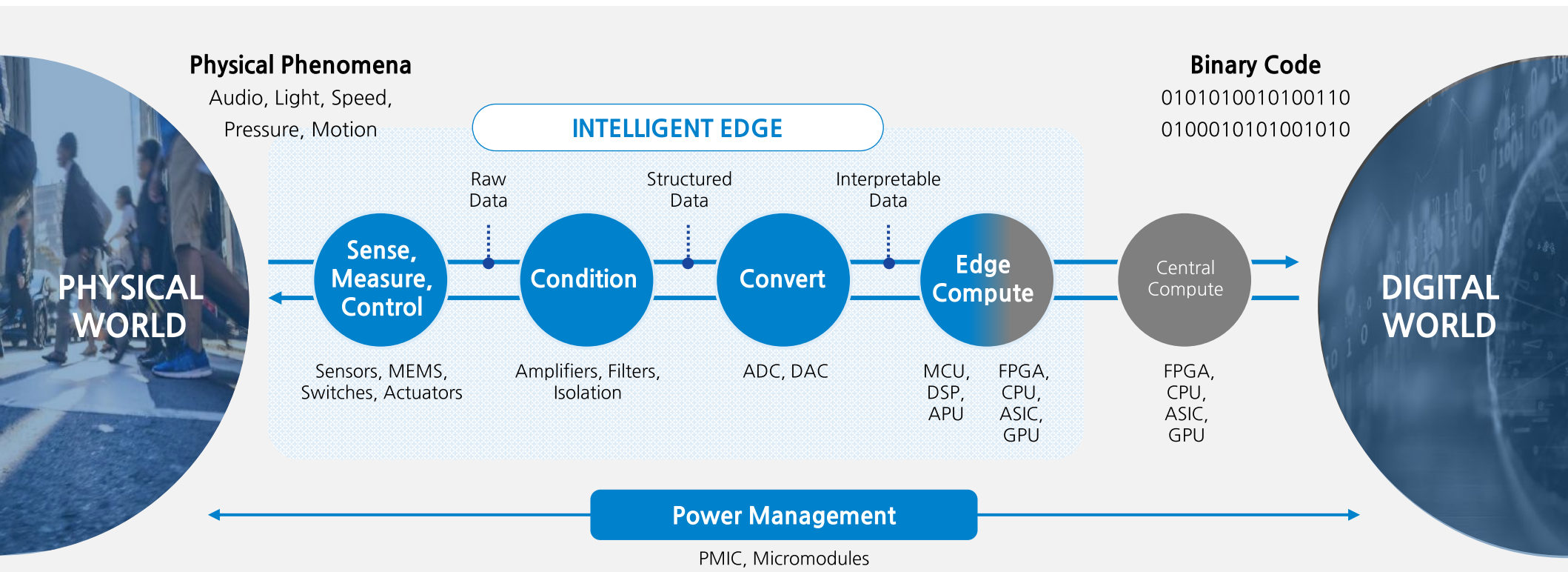


☑ 제한적인 자원 (전력, 공간, 비용 등)
→ 향후 SoC 개발 방향의 핵심 요소



AI 구성 요소 간 효율적 작동을 지원하여 전체 시스템 성능 향상

● 아이언디바이스 수행 영역 ● 아이언디바이스 비수행 영역



“ 현실 세상과 디지털 세상을 연결해 주는 핵심 기술 ”

“아날로그 + 디지털 + 파워” 기술력으로 진입 가능한 High-Growth Markets



당사 영위 사업 특징

高수요

복합 기능을 모두 구현할 수 있는 소수의 업체만 참여 가능



高성장

IT 산업 전반에 핵심 역할 수행



高수익률

고부가가치 제품으로 높은 수익 달성 가능



※ 출처: '25년 기준 각 회사 자료(단, 시가총액은 '26년 4월말 기준임)

02

About Iron Device Corp.

혼성신호 SoC 구현

Corporate Identity

사업 영역

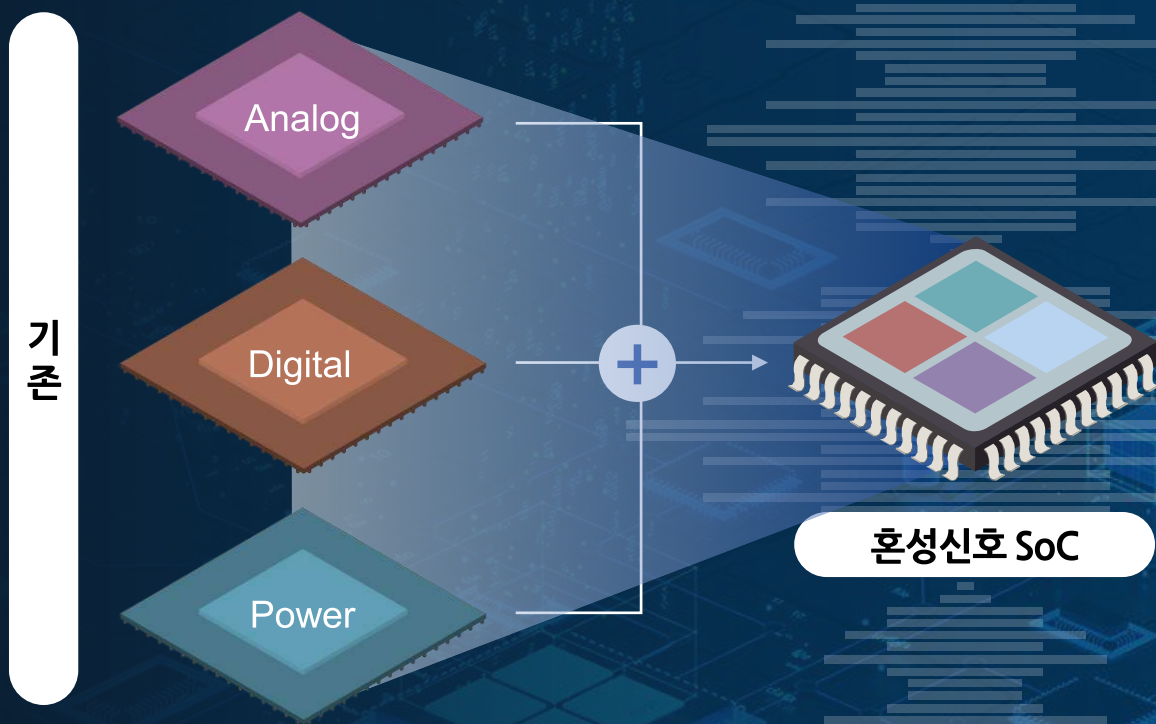
주력 제품 '스마트파워앰프' 경쟁력 ① ~ ⑤

경영 실적



아날로그 회로와 디지털 회로를 모두 한 칩(Chip)에 구현하는 초소형 시스템반도체

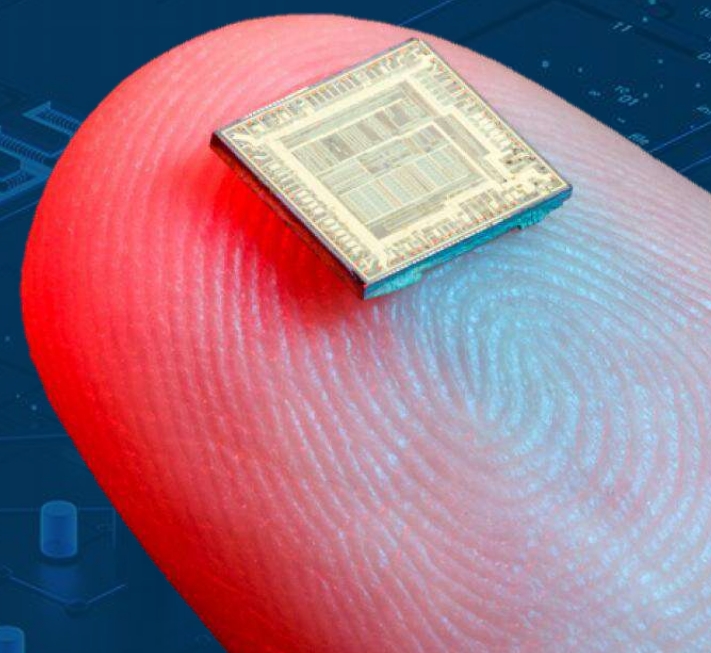
Analog, Digital, Power
3가지 혼성신호를 한 칩으로 구현



실시간
처리

소형화

전력
효율성



아날로그-디지털-파워 혼성신호 시스템 반도체 SoC 리더

혼성신호(Analog/Digital/Power) 시스템 반도체 SoC 팹리스

현실 세상과 디지털 세상을 연결해 주는 삼위일체형 기술

ANALOG

초저잡음 고성능 아날로그 회로 기술

- 저잡음 레퍼런스/앰프 설계 기술
 - AFE/센싱회로
- Sigma-Delta adc/dac, SAR adc, etc.

DIGITAL

고성능 제어 및 신호 처리 디지털 기술

- 디지털 신호 인터페이스 IP
- 디지털 신호처리 IP / 보호 알고리즘 / 필터
- Digitally-Controlled Analog 기술

POWER

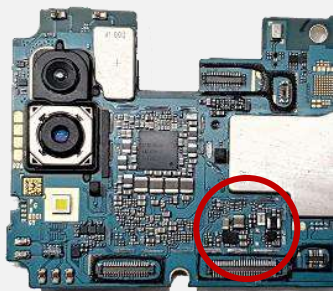
전력 전자 (Power Electronics) 기반의 파워 구동 및 센싱 기술

- 대전류/고전압 구동 파워소자 설계
- High Side Gate 구동/보호회로 기술
- 전류 센싱 및 보호 회로
(TSD, OCP, OCL, SCP, OVP, UVLO, etc.)

양산 검증된(Silicon-Proven) 혼성신호 IP 기반 적용 제품 및 응용처 확대



스마트폰 시장의 성숙기임에도 불구하고 고성능 앰프 수요 증가로 P와 Q의 확대



스마트파워앰프 SoC

제한된 전원의 환경에서 高효율, 高음질의 소리를 재생할 수 있도록 스피커를 구동하는 시스템 반도체

최대한의 음압을 얻어내면서 스피커의 신뢰성을 확보하는 위한 핵심 부품



스마트파워앰프 시장 특성

수요 증가 요인



단일 기기당 앰프 수 증가
모노 → 다채널 오디오



스마트파워앰프 적용처 확대
→ 시스피커, XR/VR 등

가격 증가 요인



스피커 크기 한계 극복
→ 소형화, 저전력



오디오 고품질 요구
→ 고기능성

글로벌 스마트폰 적용 앰프 수 현황

(단위: 백만개)



글로벌 태블릿 적용 앰프 수 현황

(단위: 백만개)



외부 환경 및 변화를 센싱 하여 스마트파워앰프 내에서 자체적으로 판단 및 출력값 조절

4가지 모두 구현되어야 제품화 가능
 → 혼성신호 SoC 반도체 반드시 필요

Analog + Digital + Power

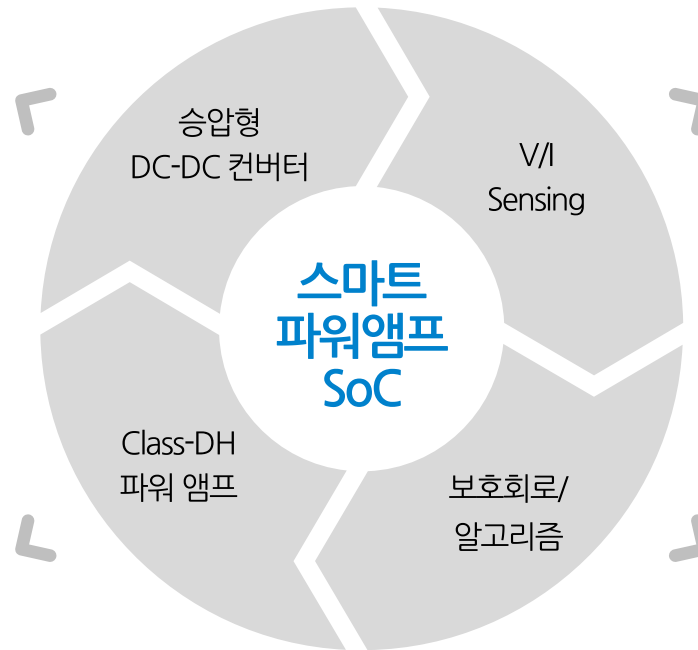
승압형 DC-DC 컨버터

- 대전류/고전압 구동 파워소자 설계 기술
- High Side Gate 구동 기술
- 가청주파수 영역을 피하는 Synchronous Boost Converter 기술
- 빠른 응답 특성을 위한 디지털 Feed-forward 기술

Digital + Power

Class-DH 파워 앰프

- 대전류/고전압 구동 H-Bridge 파워 소자 설계 기술
- High Side Gate 구동 기술
- 고음질 Digital to Power 변환 기술
- 전원변동에 따른 왜곡 보상 기술
- 출력전압 예측 기술



Analog + Digital

V/I Sensing

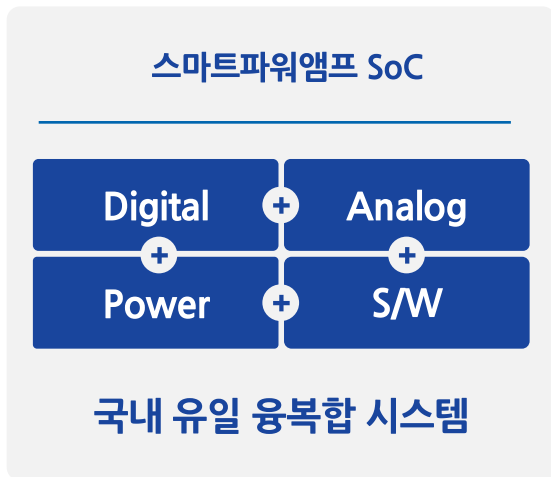
- 스위칭 출력전압의 레벨 변환기술
- 부하전류 센싱 기술
- 16bit 이상, 100kHzSPL 이상의 저전력 시그마델타 ADC
- 디지털 오디오 인터페이스 기술

Digital + Analog + S/W

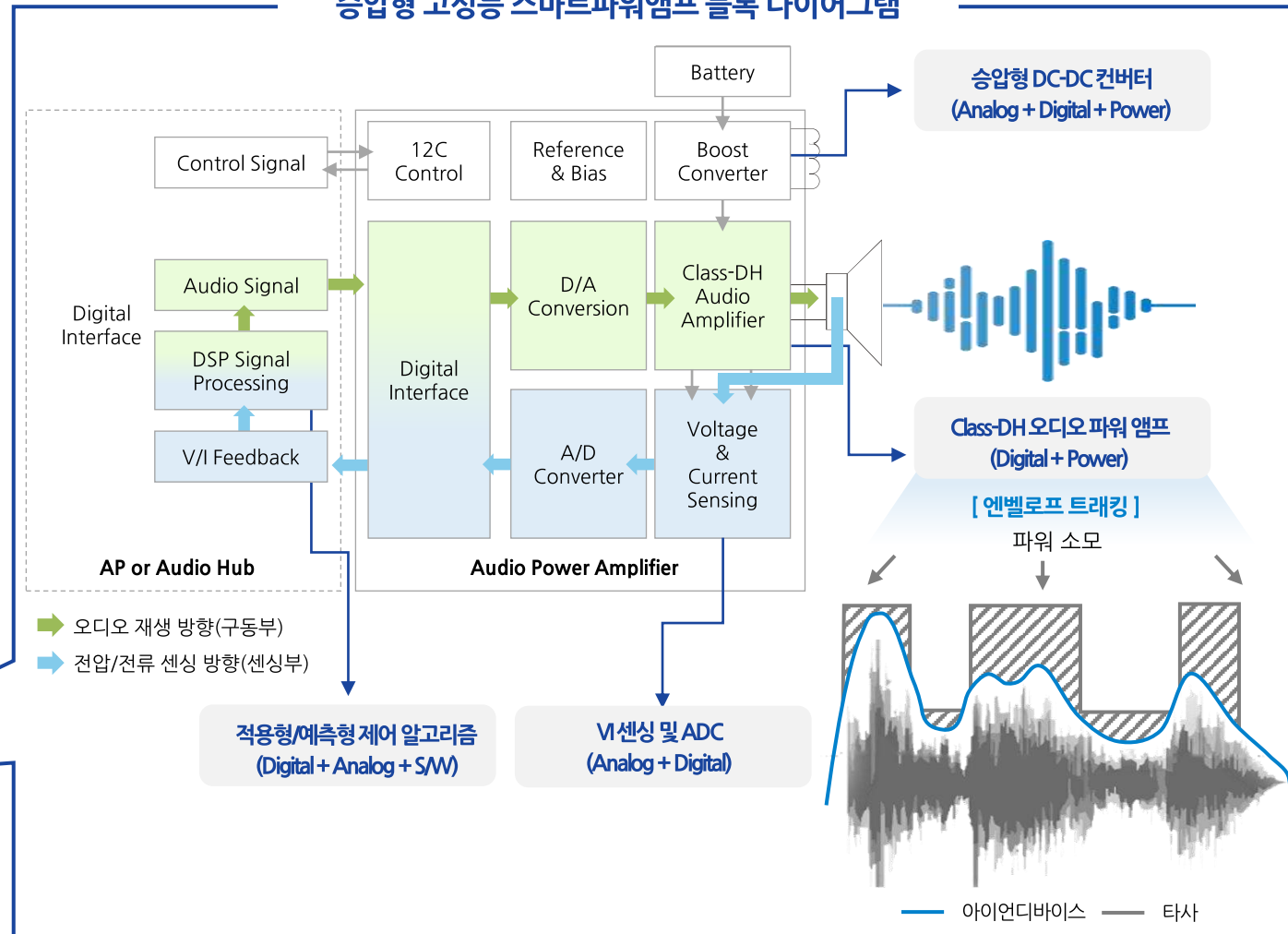
보호회로/알고리즘

- 스피커 모델링
- 제어 알고리즘 설계
- 최적화된 DSP S/W 구현
- 출력 단락, 과전류 검출 및 보호회로
- 온도 보호회로
- 정전기 보호회로

스마트파워앰프 SoC H/W 요소 기술 및 독자적인 S/W 알고리즘 보유



승압형 고성능 스마트파워앰프 블록 다이어그램



핵심 기술력 기반 오디오 앰프 반도체 시장 내 경쟁 우위 확보

고전압 / 대전력

경쟁사

- 6V, 8.5V, 10.5V 순으로 제품 발전
- 12V 이상은 신뢰성 검증 진행 중

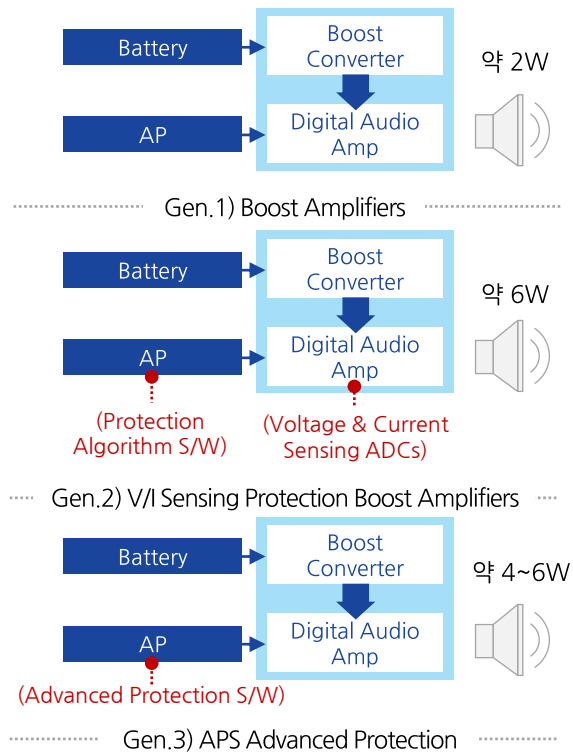
VS.



- 12V 수준에서 미세 엔벨로프 트래킹 기술기반 최고 효율 수준 달성
- 20V 양산 이력 확보 & 25V 시제품 단계 진입

BCDMOS 공정으로 단일칩으로 40V급의 고성능 디지털 앰프 제품과 기술 IP 보유
→ T와 더불어 글로벌 최고 수준

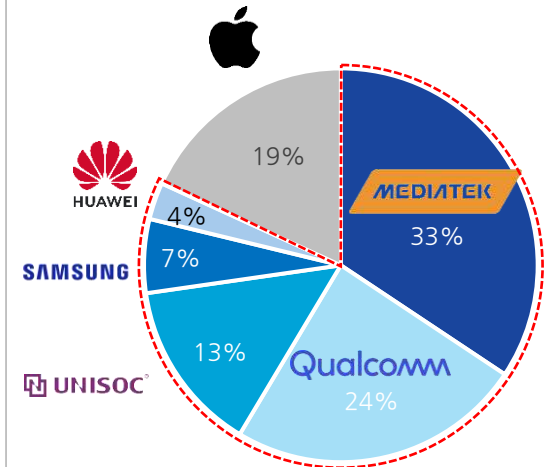
독자적인 SPA 알고리즘



F/F(feed-forward) 방식의 예측형 제어방식으로
시장 확장성 & 원가 경쟁력 확보
→ 수요처 검증 완료 및 양산 적용 중

Hardware / Software partitioned DSP¹

- MediaTek ■ Qualcomm ■ Samsung ■ Apple
- UNISOC ■ Huawei(HiSilicon)



[글로벌 스마트폰 AP 시장 점유율('26.1Q)]

출처: Counterpoint research

Qualcomm, MediaTek, Exynos AP까지
지원 가능한 SAW 역량 확보
→ 고성능 알고리즘을 저전력으로 구현 가능

주1) DSP(Digital Signal Processor): 디지털 신호 처리 장치

글로벌 최고 수준의 기술력·사업성 보유한 국내 유일 기업

◆ 주요 경쟁사와 기술 비교

(△: 개발중)

글로벌 오디오 반도체 업체			아이언디바이스	C사	G사	A사	T사	A사/Y사/T사
구분	적용 기술	양산기술	한국	미국	중국	중국	미국	일본
			팹리스	팹리스	팹리스	팹리스	IDM	IDM
고전압/대전력	BCDMOS 기술	6V 부스트 앰프(2W)	○	○	○	○	○	X
		8.5V 부스트 앰프 (4W)	○	○	○	○	○	X
		10.5V 부스트 앰프 (5W)	○	○	○	○	○	X
		12V 부스트 앰프 (6W)	○	○	○	△	○	X
		20V 부스트 앰프 (40Vpp)	○	△ (15V)	X	X	X	X
		Fine Step 엔벨로프트래킹	○	○	X	X	○	X
S/W 알고리즘	SPA 알고리즘	2세대 SPA (V/I센싱)	○	○	○	△	○	X
		3세대 SPA (예측형)	○	X	X	X	X	X
		ALSA 표준 Device Driver	○	○	△	○	○	X
적용 AP	Partitioned DSP	Qualcomm AP 포팅	○	X (자체 DSP)	○	○	○	X
		MediaTek AP 포팅	○	X (자체 DSP)	○	○	○	X
		Exynos AP 포팅	○	X (자체 DSP)	○	X	○	X

주요 경쟁업체 현황

- C사: 국내 대기업향 공급 물량 감소로 시장 내 지배력 약화
- G사: 다양한 제품군 보유한 유럽 N사의 사업부를 인수하여 기존제품으로 중상급 시장에 대량 양산 중이나 인수 후 자체 신제품 출시 지연
- A사: 저가형 승압 앰프로 중국 ODM 시장에서 큰 성장을 하였으며 중상급 모델에서 경쟁중



다수의 일본업체는 소프트웨어 중요성이 가속화 되는 디지털 전환기에 도태됨

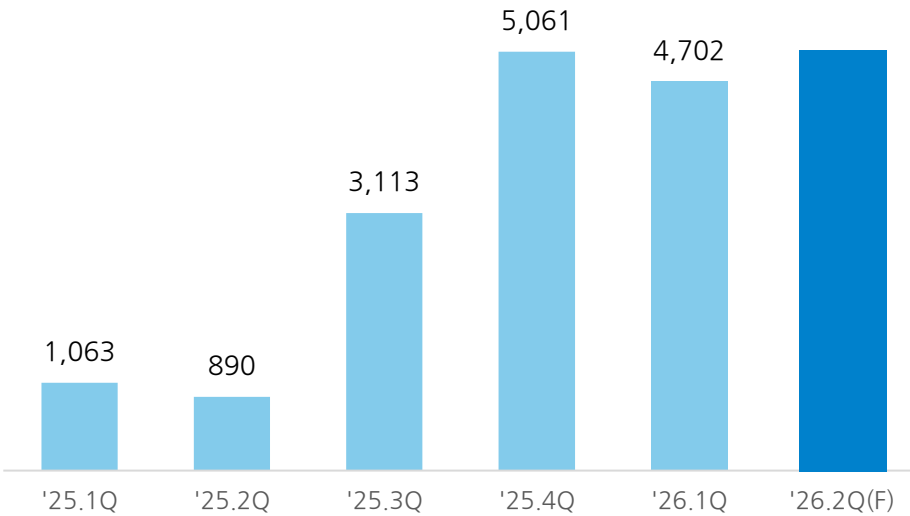
당사 경쟁우위 포인트

- 고전압 혼성신호 기술을 바탕으로 시장이 요구하는 기능의 제품을 Time-to-market으로 대응할 수 있는 기반 보유
- 자체 IP를 기반으로 한 High-Mid-Low 제품들의 포트폴리오를 구성하여 안정된 시장 점유율 확대하는 전략이 가능
- 3세대 신기술인 APS(Advanced Protection Algorithm)를 적용하여 소형 칩 사이즈에 구현할 수 있고 2세대 V/I센싱 앰프를 대체할 수준의 성능 확보 (2023년부터 양산 적용)

26.1Q 매출 47억원, 글로벌 고객사향 안정적 공급 물량 확보로 견조한 분기 매출 지속 → 26.2H 차량용 공급 물량 확대 및 신규 칩 공급을 통한 수익성 개선

◆ 분기별 매출 추이

(단위: 백만원)

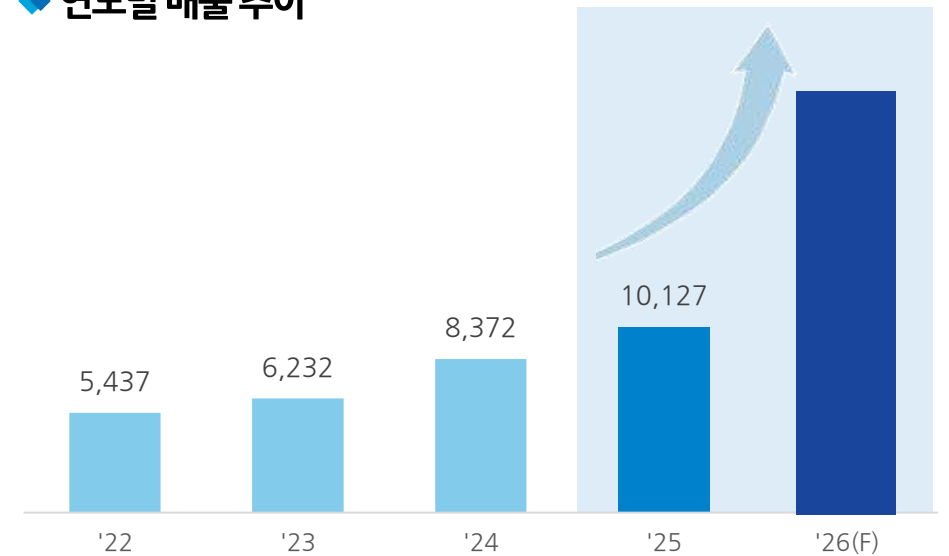


'26년 1분기 Review

- 1분기 매출액은 47억원을 기록하며 YoY 342% 증가
→ 스마트파워앰프의 안정적인 공급을 통해 견조한 분기 매출 달성 및 수익성 개선
- 전력반도체 선도 기업 EPC(Efficient Power Conversion)사와 협력 체계 구축
→ 자사의 GaN용 파워IC 제품인 SMA6533이 EPC사 'Half-Bridge GaN Gate Driver' 추천목록에 등재
- 차세대 로봇·모빌리티용 GaN 기반 '3상 모터 인버터' 시스템 공개
→ 제33회 한국반도체학술대회(KCS 2026) 참가해 GaN 소자를 적용한 고성능 '3상 모터 인버터(3-phase Motor Inverter)' 시스템 공개

◆ 연도별 매출 추이

(단위: 백만원)



'26년 2분기 Preview

- 주요 고객사향 공급 물량 확보로 안정적인 분기 매출 지속
→ 주요 고객사와 공고한 협력 체계를 바탕으로 안정적인 공급 물량 납품 지속
→ 차세대 5G 스마트폰 모델향 공급 확정으로 매출 가시성 확보
- 대만 신규 고객사 확보로 차량용 제품 매출 증가
→ 대만 신규고객사 S사향 차량용 AI 대시캠(Dash Cam)용 스마트파워앰프 공급
→ 대만 글로벌 기업 L사와도 양산 일정 조율
- 차세대 파워IC 시장 선점 및 글로벌 프로모션
→ EPC사와 GaN 게이트드라이버 글로벌 프로모션 및 고효율 파워 솔루션 개발 협력

03

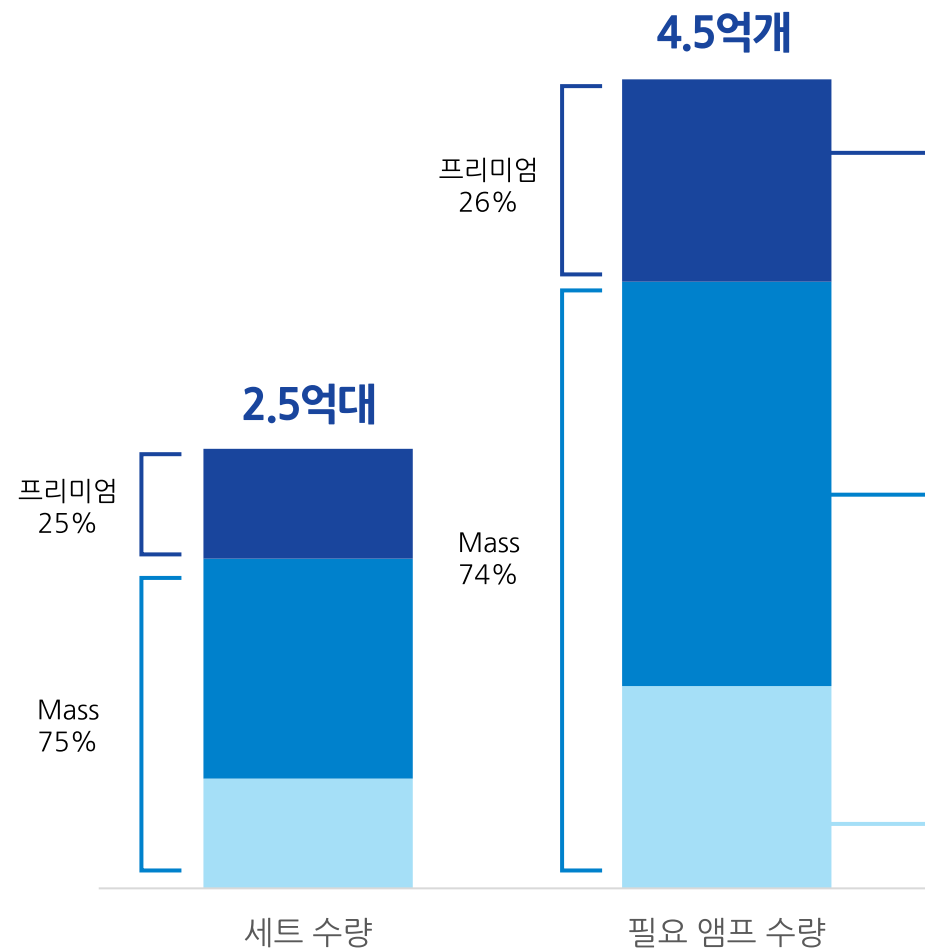
Core Business

주력 제품 '스마트파워앰프'의 성장 ① ② ③
확장 제품의 신규 시장 진입
진입 장벽



고객사 니즈에 맞는 세그먼트 별 타겟 전략 수립 → M/S 30% Target

◆ 2025년 대표 수요처 수량



◆ 대응 제품군

V/I Sensing Smart PA	<ul style="list-style-type: none"> • Smart PA(S/W DSP) / 6W ~ 7.5W → 6W급 이상 제품 개발 완료 → 주요 고객사 하이엔드 스마트폰 공급 계획
High Boost Amp	<ul style="list-style-type: none"> • High Boost Amp / 4W (with APS / 6W) → 기존 납품 Reference 기반 모델 확대 → 태블릿형 4W급 앰프 4개의 전력을 동시에 처리할 수 있는 스마트파워앰프 공급
Boost Amp	<ul style="list-style-type: none"> • Boost Amp / 2.6W → 검증된 제품으로 Entry급 스마트폰 시장 공략

※ 자사 추정

음성인식 기반 AI 인터페이스 중요성 부각

“AI needs a new terminal because it changes the way it interacts with computers from the ground up”

“Voice (manipulation) will be the key”

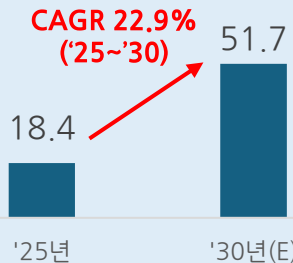
OpenAI CEO Sam Altman(2025)

글로벌 기업들의 음성인식 기반 AI 개발 증가 추세

OpenAI Apple ...

[글로벌 음성인식 시장 규모]

(단위: 십억 달러)



현황

글로벌 빅테크 기업들의 음성인식 정확도를 높이기 위한 경쟁 치열

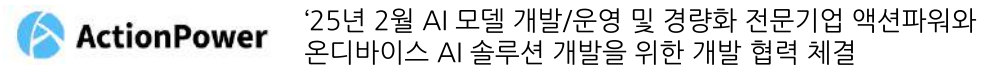
01 칩단위(H/W)에서 코덱 기능(IP블록형태)을 보유한 소수 기업 중 하나



02 8채널 MIC 연결 및 음성인식 지원이 가능한 당사 자체 제품 적용 이력 보유



03 소프트웨어(S/W)에서 필요로 하는 기능을 반도체 칩에서 구현 가능



아이언디바이스
음성인식 분야
주요 경쟁력

주력 제품 ‘스마트파워앰프’ 경쟁력 기반
차세대 스마트 디바이스로 확장



예) 메타의 Ray-Ban 스마트 글라스, 5 Mic array

스마트파워앰프 주변 환경을 읽는 인공지능(AI) 센서 역할로 진화



스마트파워앰프는 모터드라이버, AR/VR/XR, 디스플레이사운드앰프 등으로 확대 적용 가능

오디오-햅틱드라이버 SoC



촉각과 오디오를 함께 결합하는
‘오디오-햅틱’ 신기술

산업 동향

- 구글의 오디오 결합 햅틱 효과 도입
- 안드로이드 스마트폰 고급 햅틱 탑재율 증가 전망
- '20년 이후 3~4년 동안 시장 규모 두 배 성장 예상

적용 산업

스마트폰, 웨어러블, 태블릿,
게임 콘솔 및 컨트롤러, 자동차, VR/AR 등

사업 현황

- 세트업체 S사와 제품화를 위해 개발 중이며, 엔지니어링 샘플 확보되어 S/W 포함한 검증 진행 중
- 산자부와 스마트 기기 촉각 반응을 위한 12V 승압형 VI 센싱 오디오 햅틱 드라이버 SoC 정부 과제 수행 완료
- '26년 양산용 시제품 출시 예정

AR/VR/XR 스피커앰프



AR/VR/XR 기기에서 오디오 관련 기능은
매우 중요하며 인간과 소통하는 핵심 기술

산업 동향

- 삼성, 메타, 소니 등 제품 출시 완료
- 애플, 구글, 샤오미 등 제품 개발 진입
- 매년 앰프의 출력 증가하는 수요 지속
- '23년~'27년 시장 규모 32.6% CAGR 성장 전망

적용 산업

VR/AR, 게임, 엔터테인먼트, 교육,
산업 디자인 및 프로토타이핑 등

사업 현황

- 애플 비전 프로와 메타 퀘스트 등 공간컴퓨팅 기기로 적용을 확대하기 위해 차세대 VI 센싱 파워 앰프 개발 중
- AR/XR 디바이스는 스마트 앰프가 4개까지 사용되고 있어, 당사도 글로벌 세트업체 니즈를 반영한 시제품을 준비 중

디스플레이사운드앰프 SoC



OLED 디스플레이에 세라믹 피에조(Piezoelectric, 압전)
소자를 붙여 스피커(트랜스듀서)로 사용하는 새로운 기술

산업 동향

- 스마트 기기의 베젤리스/포트리스/버트리스 디자인 추세
- 세트 개발 업체의 지속적 니즈 존재
- 국내 업체 S사, I사는 패널 제작사에서 적극적 적용 진행
- 해외 업체 세트 및 부품 업체 전반의 상용화 R&D 지속

적용 산업

스마트폰, 웨어러블, 태블릿,
TV, 자동차, 게임, 디스플레이 광고 등

사업 현황

- 세계 최초 스마트폰 양산 적용 이력 보유
- 세트업체와 노트북/모니터 등 디스플레이사운드 개발 중이며, 고객사 최종 데모 진행 중
- 세트업체와 시제품 제작 후 3GPP 테스트 진행 중
- 글로벌 C사와 필름형 세라믹 액츄에이터 구동을 위한 고전압 구동 SoC 상용화 개발 착수 (25.09 ~ 26.09)

※ 출처: Counterpoint research, IDC, 2023.6

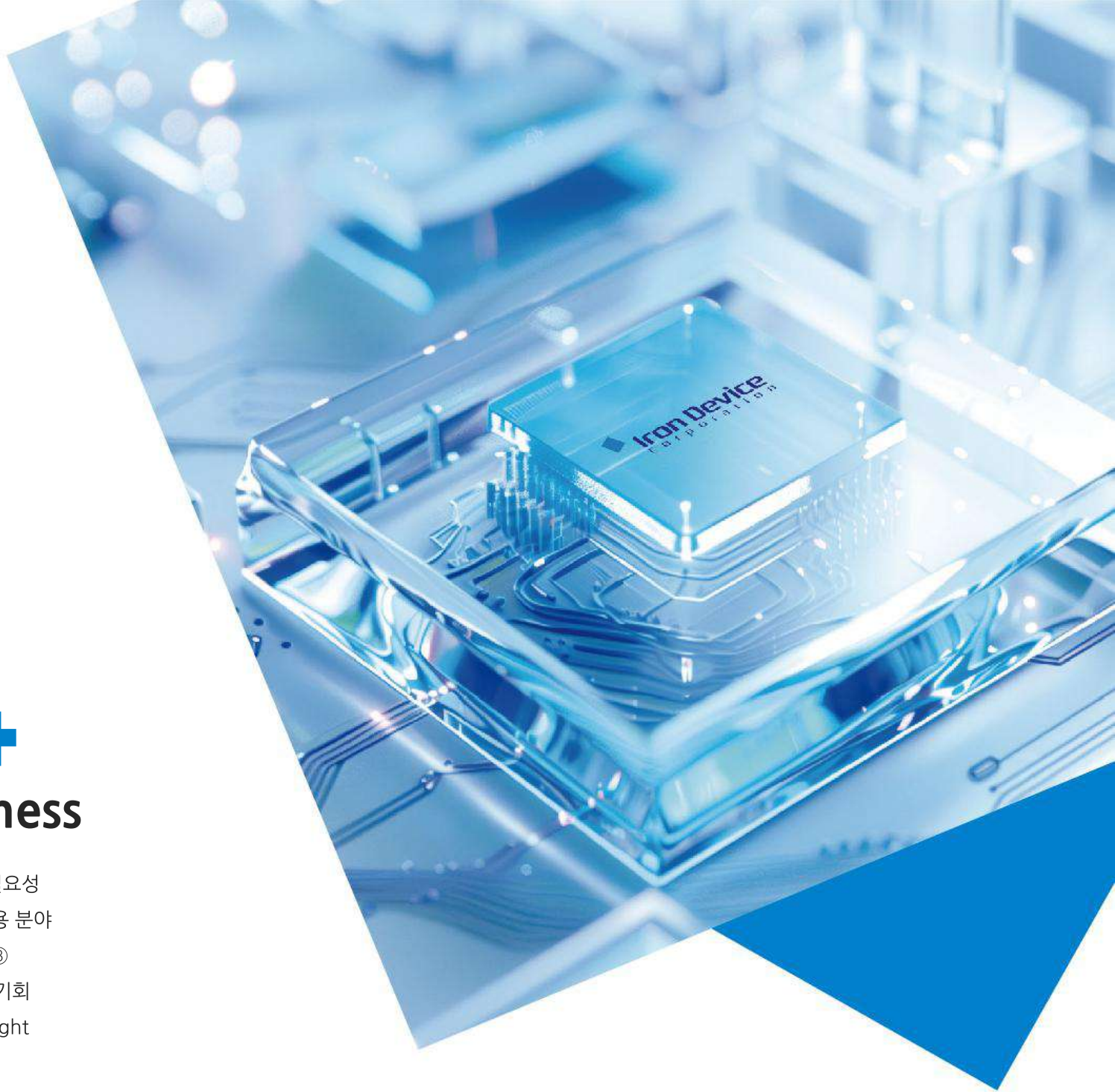
저출력에서 고출력까지 다룰 수 있는 혼성신호 기술 진입장벽 및 향후 확장성



04

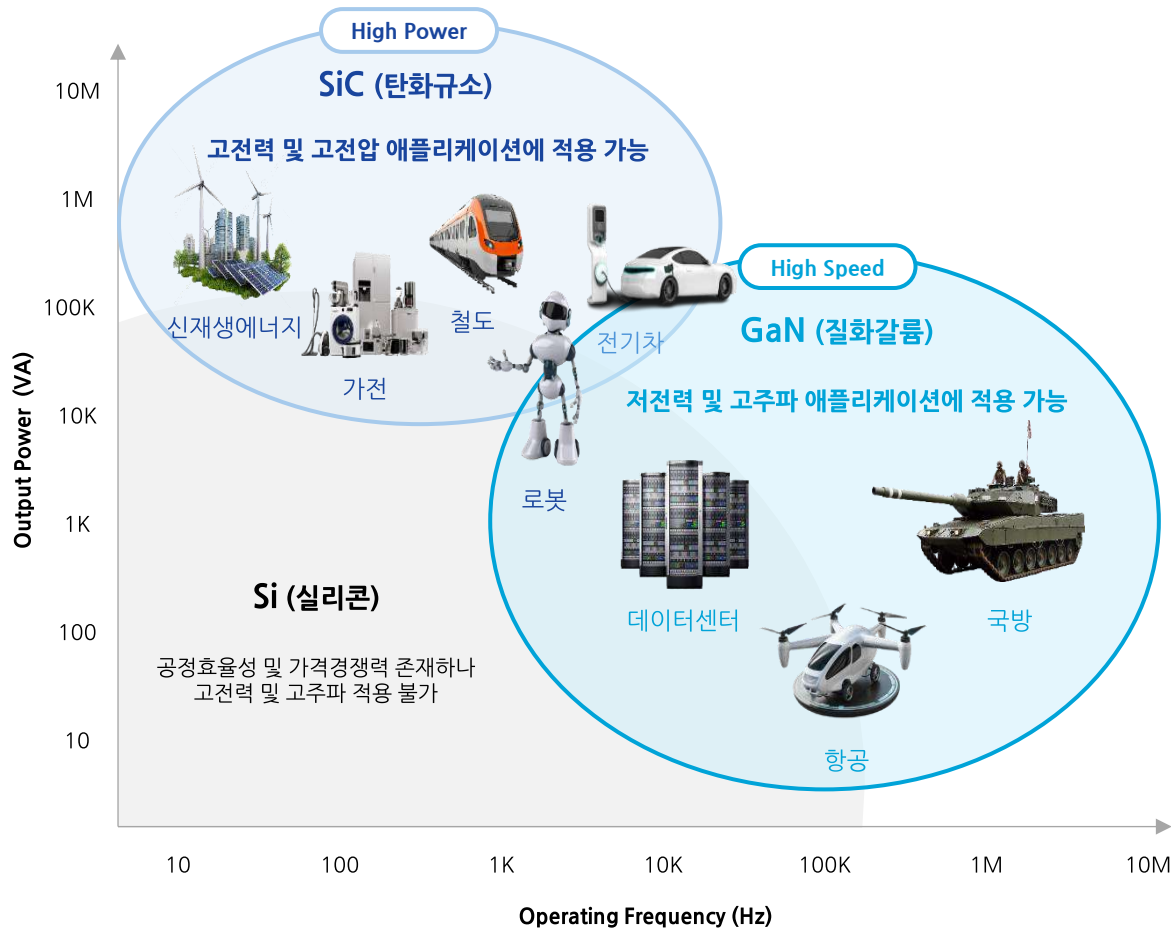
New Business

화합물 전력반도체 필요성
화합물 전력반도체 활용 분야
개발 현황 ① ② ③
반도체 시장 변화와 기회
Technology Highlight



기존 Si 전력반도체 대비 전력 효율이 우수한 SiC·GaN 등 화합물 전력반도체 소자의 필요성 부각

◆ 화합물 전력반도체 개요



화합물 전력반도체 특징

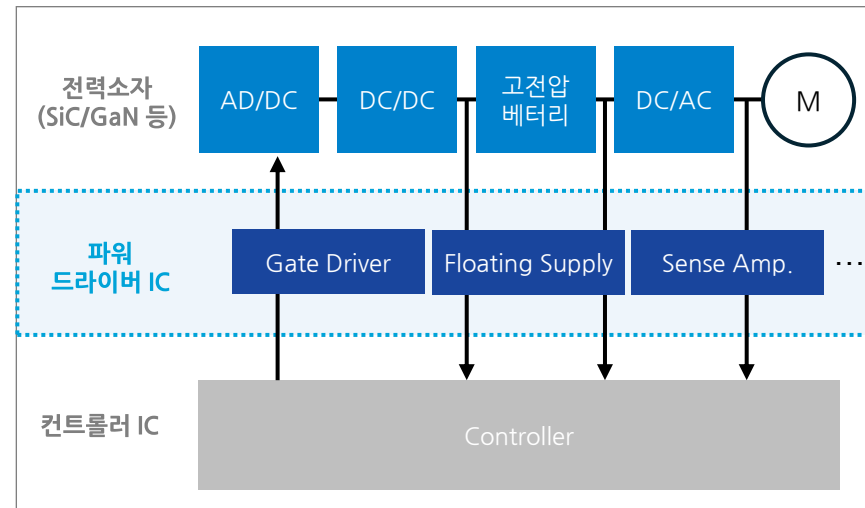
소형화 가능

전력 소비 감소

발열량 감소

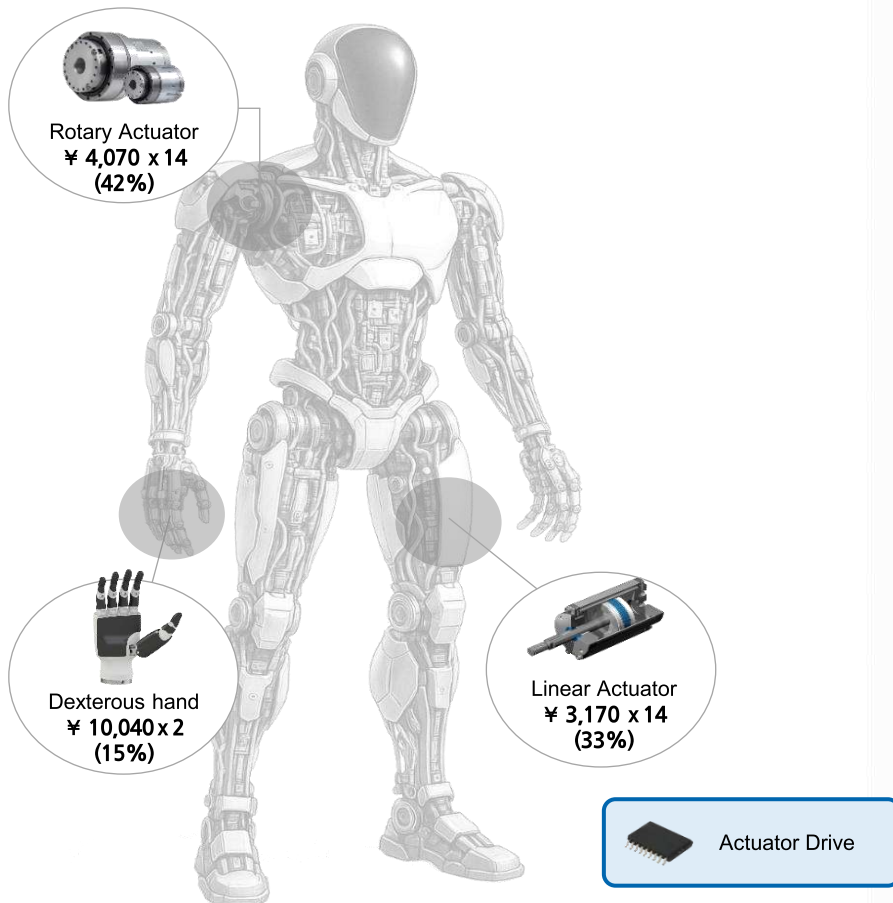
전력소자는 그에 맞는 파워 드라이버 IC가 있어야 제 성능을 발휘
 → 응용처 별 파워 IC 세분화 필요

예시) 파워 반도체 소자(GaN, SiC) 적용 파워 변환 시스템

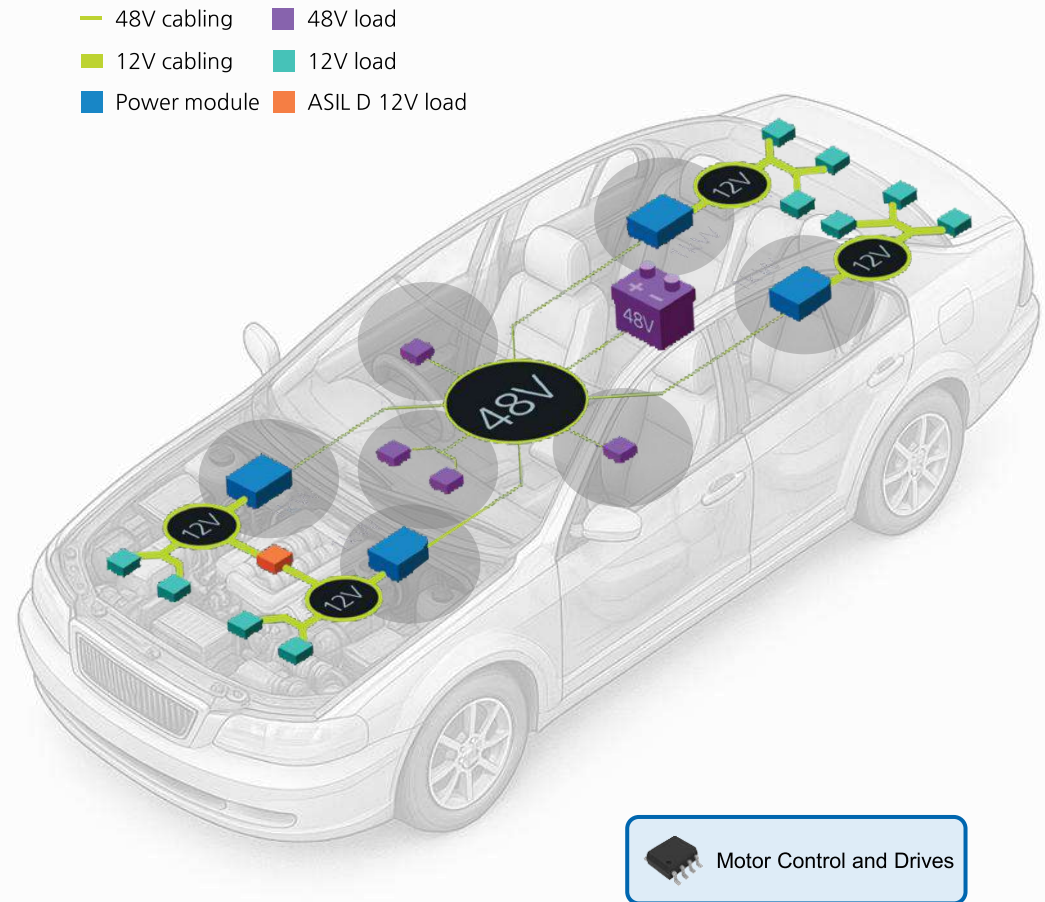


휴머노이드 로봇 및 모빌리티 시장 변화에 부합하는 고부가가치 제품 개발

◆ 로봇 구동을 위한 스마트 액추에이터 드라이버

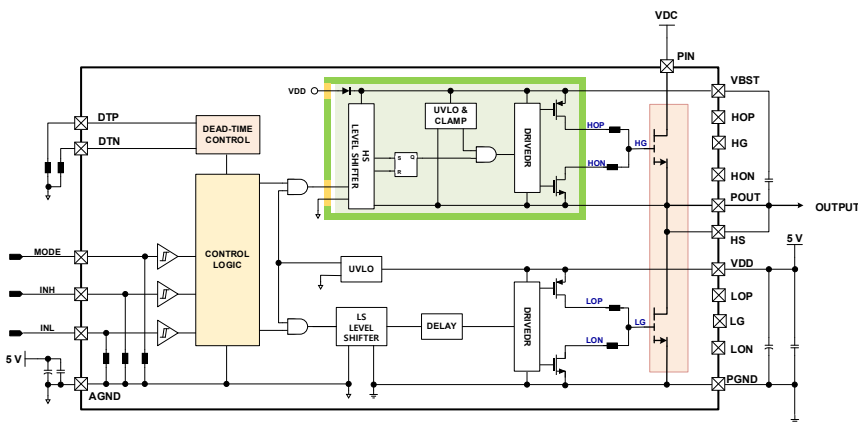


◆ 차량용 48V 전기·전자 시스템에 최적화된 솔루션

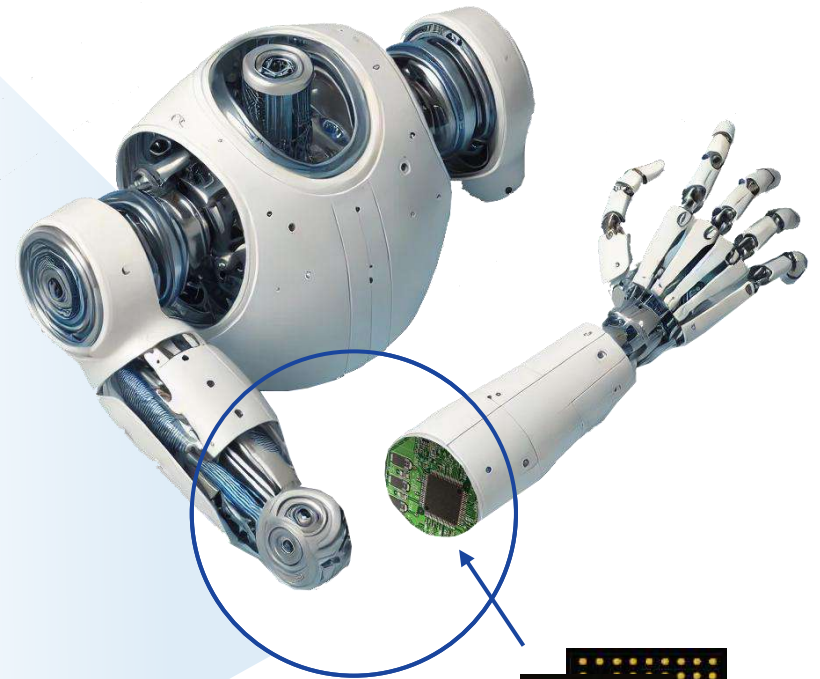


GaN 화합물 전력반도체 소자를 활용한 파워 드라이버 IC 개발 완료

Integrated-Dies™ WLP



- 패키지: 90-ball FoWLP (4.9 mm x 5.0 mm)
- 100V GaN 및 하프-브리지드라이버
- Bootstrap 동작을 위한 최대 +100 V 플로팅 전원
- 플로팅 전원용 내장 Bootstrap 다이오드
- GaN FET용 4.5 V ~ 5 V 공급 전압 범위
- 3 A Source 및 6 A Sink Peak 구동 전류
- 빠른 전달 지연 시간 (일반 24ns)
- 채널별 독립적인 Undervoltage Lockout (UVLO)
- 정밀한 Dead-Time 조정 기능
- MODE, INH, INL 핀을 통한 입력 모드 제어
- 동작 온도 범위: -40 °C ~ 125 °C
- 응용처: 고효율 오디오앰프, 로봇 액추에이터 드라이버 및 컨버터

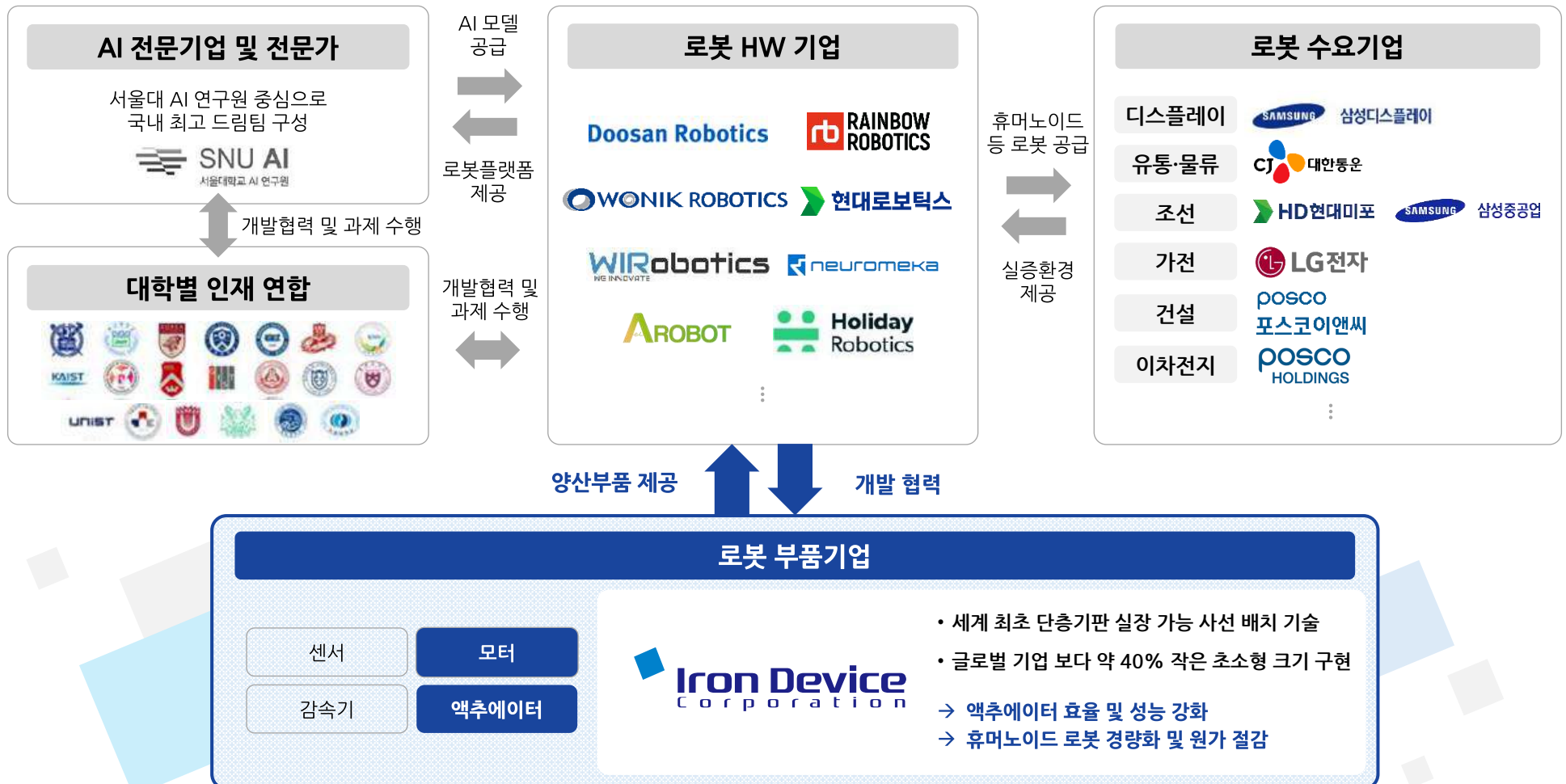


GaN Power Module for Smart Actuator

※ WLP: Wafer-level package

정부 주도 전략 프로젝트 'K-휴머노이드 연합' 참여기업 선정 → 휴머노이드 로봇 액추에이터 구동 위한 전력제어 시스템반도체 개발

◆ K-휴머노이드 연합 추진 체계



※ 출처: 산업통상자원부

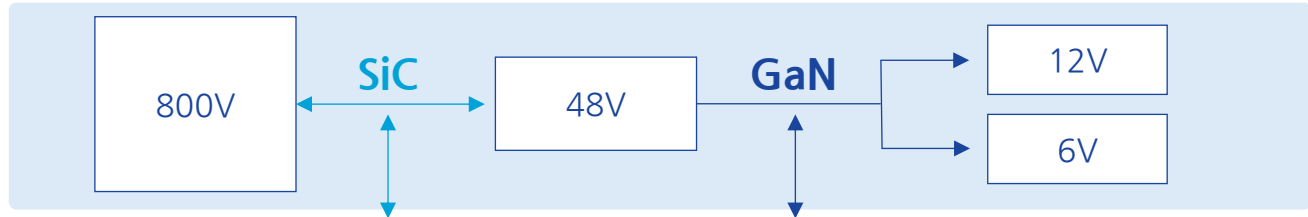
AI 데이터센터 고전압화 → 단계적 저전압 변환 과정에서 SiC·GaN Gate Driver 수요 확대



AI 데이터센터 800 VDC 기반 전력 전환

- AI 모델 고도화로 데이터센터 전력 수요가 MW급으로 급증함에 따라 기존 54V 전력 분배 방식 한계 직면
- NVIDIA는 2027년부터 1MW(메가와트)급 이상을 지원하는 800V HVDC(고전압직류송전) 방식 도입 선언

◆ 단계적 전압 변환 구조



SiC 전력소자 구동용 게이트드라이버



SMA6544

[주요 특징]

- 절연형 싱글 채널 게이트드라이버
- Active Miller Clamp 기능 내장
- 최소 150 V/ns CMTI
- 빠른 전달 지연 시간 (일반 80ns)
- CMOS 호환 입력 임계 전압

▶ 800V 전원을 사용하는 SiC 컨버터(1200V급 소자 사용) 및 게이트드라이버 개발 중

GaN 전력소자 구동용 게이트드라이버



SMA6533

[주요 특징]

- Bootstrap 동작을 위한 최대 +100V 플로팅 전원
- Turn-on/off 세기 조절이 가능한 분리형 출력
- 최소 50 V/ns CMTI
- 빠른 전달 지연 시간 (일반 24ns)
- 보호 기능: 저전압 오동작 및 동시 도통 방지

▶ 차세대 GaN 게이트드라이버 IC 개발 완료 및 상용화 추진 중

게이트드라이버 IC 역할 및 특징점

게이트드라이버 IC는 전력반도체 소자가 작동하도록 제어하는 파워 구동 칩입니다. 전력 신호를 변환·분배하는 핵심 기능을 수행할 뿐만 아니라, 전력 소자를 정밀하게 컨트롤(On/Off)하여 시스템을 보호하는 역할을 합니다.

고속 스위칭

- 기존 실리콘(Si) 소재 대비 약 100배 빠른 초고속스위칭 지원
- 전파 지연 시간(Propagation Delay)을 20ns 수준으로 단축해 고정밀 제어 구현

갈바닉절연

- 전류·전압의 물리적 차단을 통해 전기적 노이즈 및 시스템 장애 예방
- 데이터 정확성과 안전성을 보장

고효율 · 저발열

- 전력 변환 과정의 손실 최소화로 시스템 전체 에너지 효율 극대화
- 구동 발열을 근본적으로 낮춰 효과적 열 관리 및 장시간 안정적 동작 보장

피지컬 SI 구현을 위한 독보적 반도체 설계 역량 내재화

시장 특성

반도체 설계
난이도 증가

아날로그
반도체 설계
희소성

차세대
전력반도체
(GaN · SiC)
채택 본격화

시장의 요구

고난도 설계역량

초고속 처리

저전력

초소형

고난도 기술 영역

양산 · 공급 레퍼런스

HW 설계 전문 인력

고출력 · 고전압 · 고효율

고속 스위칭

시스템 통합을 통한 비용 · 크기 감소



피지컬 AI 시대를 선도하는 국내 유일 융복합 솔루션 파트너
(Digital + Analog + Power + S/W)



Appendix

회사 개요
회사 연혁
R&D 현황
주요 파트너십
글로벌 진출
요약 재무제표



삼성전자, 페어차일드 출신 전문 인력들로 설립된 혼성신호 SoC의 리더

◆ 회사 개요

회사명	(주)아이언디바이스
대표이사	박기태
설립일	2008년 5월 1일
자본금	6,982백만원
매출액	10,127백만원 ('25년 기준)
사업 분야	혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매
임직원 수	49명 ('26년 3월 기준)
소재지	서울시 강남구 강남대로 636, 7층 (신사동, 두원빌딩)
홈페이지	www.irondevice.com

◆ 회사 연혁

혼성신호반도체 분야
경력 31년 전문가

대표이사 **박기태**

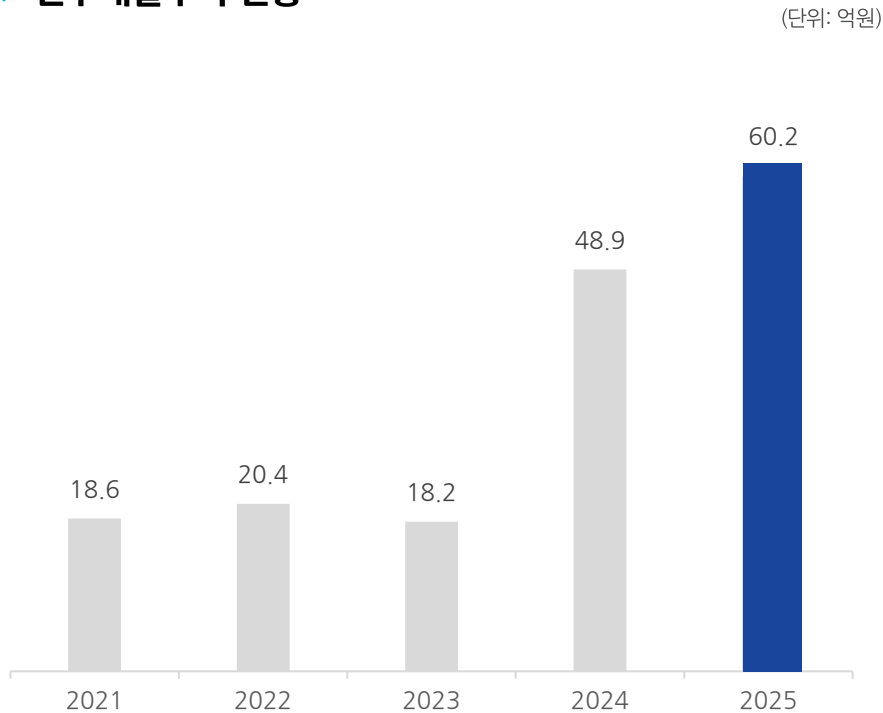
- (주)아이언디바이스 대표이사
- 삼성전자 반도체 책임
- 페어차일드(온세미) 반도체 선임
- 서울대학교 전기공학과 학사/석사 졸업

- '25년 12월 말 기준,
핵심기술인력 평균 업력 24년
임직원 평균 업력 14년
- Market Proven
스마트파워앰프 SoC 제품
누적 3억개 판매
- 설계 분야 국내 탑티어
독보적 기술 수준 확보

2008~2015		2016~2022	2023~
Phase-I		Phase-II	Phase-III
Process / R&D Setup IP Development		Product Development	Branded Product
2008 ▶ 법인설립 ▶ TSMC, Key Foundry, UMC, DB Hitek 등 주요 Foundry 계약 ▶ 벤처기업 인증 ▶ 유럽 고성능 오디오 회사와 제품개발 계약 2009 ▶ 스마트-SOC 외 국책과제 진행 2010 ▶ 무역협회 가입 2012 ▶ 기업부설 연구소 설립 2013 ▶ 연구개발 서비스업 신고 2014 ▶ 산업통상부 스타트업 기업 선정 2015 ▶ 부품소재 전문기업 등록		2016 ▶ 전략적 투자자 유치 2017 ▶ 덴마크 지사 설립 2017 ▶ (주)실리콘마이터스 계열사 편입 2017 ▶ 1200V SiC 구동용 파워IC 개발 착수 (30개월) 2018 ▶ 당사 기술제품의 제품적용 (S사 스마트스피커) (*실리콘마이터스 제품) 2019 ▶ 당사 기술제품 적용 확장 (S사/가사 스마트폰 등) (*실리콘마이터스 제품) 2019 ▶ GaN IPM용 파워IC 개발 착수 (45개월) 2020 ▶ HiFi DAC 피에조 스피커 앰프 출시 2021 ▶ Galvanic Isolation 드라이버 시제품 출시 2021 ▶ SMA 시리즈 누적 2.5억개 판매 2021 ▶ 자체 생산제품으로 공급 시작(S사 스마트폰) 2021 ▶ Series-A 투자 유치 2022 ▶ Audio 부문 독립 SCM 운영 2022 ▶ 자체 생산제품 2천만개 공급 2022 ▶ SiC컨버터 스마트파워IC 국책과제	2023 ▶ 예측제어방식 스마트파워앰프 양산 2023 ▶ Series-B 투자유치 2023 ▶ 대만 Q사에 차량용 앰프 공급 시작 2023 ▶ 소부장 기술특례평가 통과 2023 ▶ 화합물 전력반도체 고도화 사업 참여 (45개월) 2024 ▶ 코스닥 상장 2025 ▶ 본사 확장 이전 (신사동, 두원빌딩) 2025 ▶ GaN 전력소자구동용 게이트드라이버 IC 개발 2025 ▶ 한국생산기술연구원 파트너 기업 선정 2025 ▶ K-휴머노이드 연합참여기업 선정 2025 ▶ 필름형 세라믹 액츄에이터 구동용 고전압 SoC 과제 선정 2026 ▶ K-휴머노이드 연합참여기업 선정 2026 ▶ 유형자산 양수 (판교 유스페이스1 A-401호, A-402호) 2026 ▶ 자체 생산제품 1억개 공급 2026 ▶ 전기자동차용 구동회로 내장형 파워모듈 기술개발 과제 선정

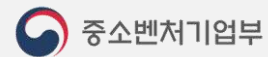
국내외 반도체 경력 위주의 전문 인력으로 구성된 조직

◆ 연구개발투자 현황



국가 R&D 과제

총 14건



핵심 기술별 특허

42건(등록31/출원11)



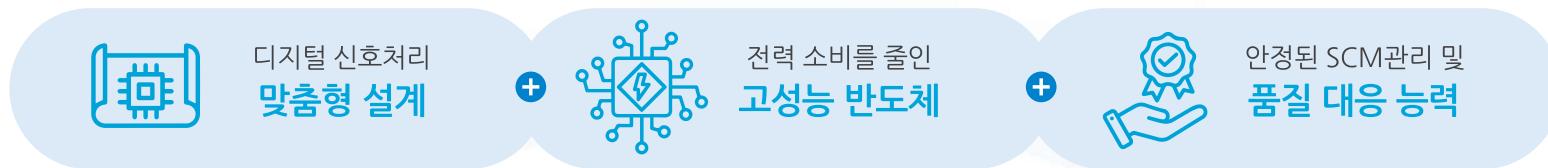
모바일 부스트 앰프 / 디스플레이 사운드 앰프 / 디지털 앰프 / 주변 회로

풍부한 경험
삼성전자 시스템 LSI 출신 팀원들
주축으로 개발팀 구성

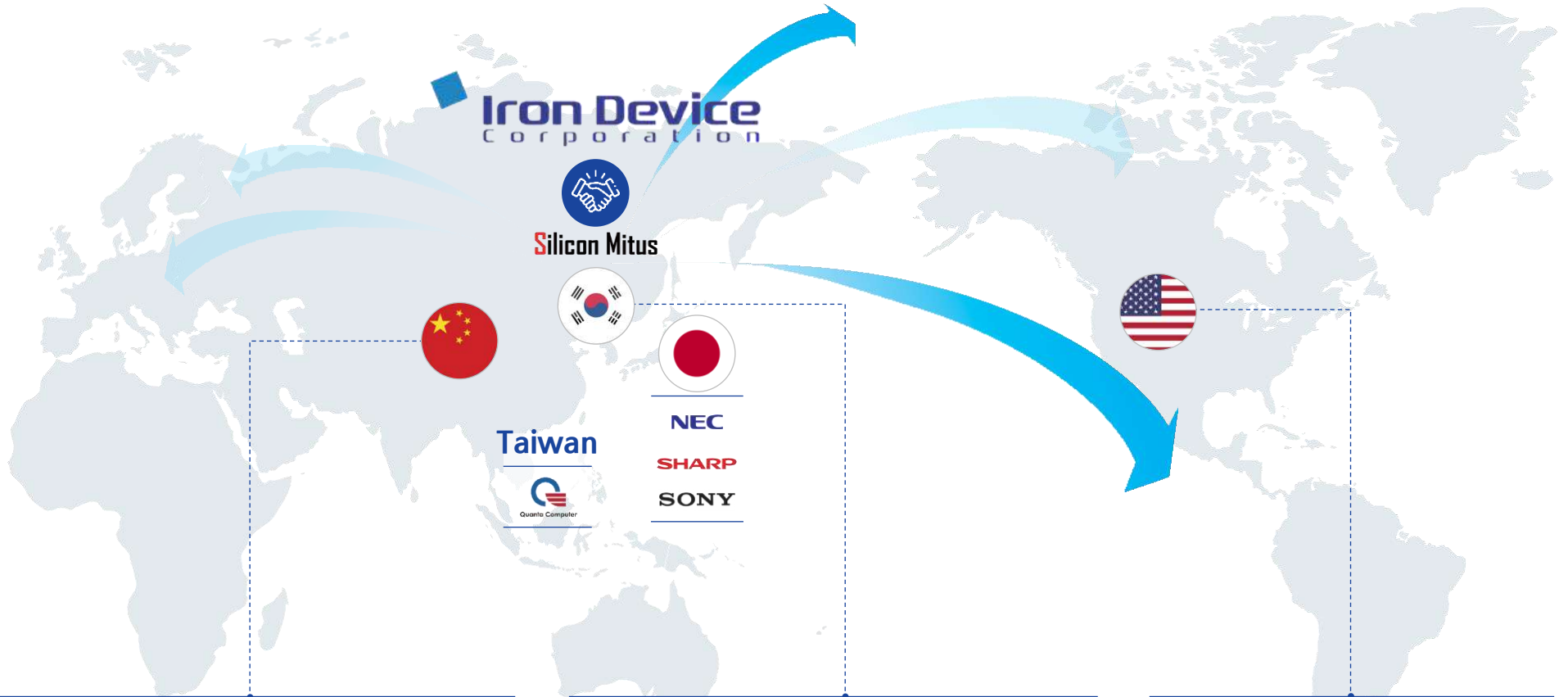


설립 이후 양산 공급 이력
누적 3억개 이상 양산 실적 달성

기획부터 설계 및 검증의 단계를 거쳐 양산 성공, 높은 품질 관리와 신뢰성 확보



글로벌 탑티어 고객사 확보 및 다양한 산업으로의 적용 추진



HUAWEI oppo vivo BOE ZTE
 Lenovo TCL mi xiaomi MEIZU HQ HUAQIN
 LONGCHEER LUXSHARE ICT TONLY HONOR

SAMSUNG SAMSUNG DISPLAY
 LG전자 LG디스플레이
 HYUNDAI MCNEX HARMAN

Google DELL hp
 Meta amazon

06 요약 재무제표

◆ 요약 재무제표

(단위: 백만원)

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
유동자산	15,579	31,837	27,378	26,236
비유동자산	2,839	4,916	6,780	6,666
자산총계	18,419	36,753	34,158	32,902
유동부채	2,051	2,406	4,894	4,038
비유동부채	2,003	3,182	2,663	2,731
부채총계	4,055	5,588	7,557	6,769
자본금	5,282	6,982	6,982	6,997
자본잉여금	18,303	37,588	37,588	37,631
기타자본구성요소	307	392	595	631
기타포괄손익누계액	(40)	(88)	(282)	(270)
이익잉여금(결손금)	(9,487)	(13,708)	(18,282)	(18,856)
자본총계	14,364	31,166	26,601	26,133

◆ 요약 손익계산서

(단위: 백만원)

구분	FY23	FY24	FY25	1Q26
매출액	6,232	8,372	10,127	4,702
매출원가	3,907	5,548	6,828	3,382
매출총이익	2,326	2,823	3,299	1,320
판매비와 관리비	5,841	7,699	8,874	2,321
영업이익(손실)	(3,516)	(4,876)	(5,575)	(1,001)
금융수익	357	1,326	1,234	434
금융비용	1,334	292	765	125
기타수익	90	118	46	9
기타비용	21	18	102	0
법인세비용차감 전순이익(손실)	(4,423)	(3,742)	(5,162)	(683)
법인세비용(수익)	(497)	478	(621)	(75)
당기순이익(손실)	(3,925)	(4,221)	(4,541)	(608)



혼성신호 시스템 반도체 SoC 리더

(주)아이언디바이스

서울시 강남구 강남대로 636, 7층 (신사동, 두원빌딩)

Tel: 02-541-2896 | Fax: 0505-541-2896